

(107) 進修部 電子工程系 四技 全學程開課時序表

第一學年(107)					
	科目	第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必修	◎體育	1	2	1	2
	☆全民國防教育軍事訓練(一)(二)	0	1	0	1
	◎英文(一)(二)	2	2	2	2
	◎中文閱讀與表達(一)(二)	2	2	2	2
	△物理(一)(二)	2	2	2	2
	△物理實驗(一)(二)	1	2	1	2
	△微積分(一)(二)	3	3	3	3
		2	2		
	※電路學(一)(二)	3	3	3	3
	※基本電學實習			1	2
小計		16	19	15	19
選修					
必修					

第二學年(108)					
	科目	第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必修	◎分類通識	2	2	2	2
	◎科技英文(一)(二)	2	2	2	2
	◎歷史文明通論	2	2		
	◎工程倫理	1	1		
	◎法政與社會			2	2
	※電子學(一)(二)	3	3	3	3
	※數位邏輯設計	3	3		
	※工程數學	3	3		
	※類比電子實習	1	2		
	※計算機程式實習	2	2		
	※電腦輔助電路佈線實習			1	2
	※數位系統設計			3	3
	※視覺化程式設計實務			2	2
	※數位邏輯實習			1	2
※電路程式模擬實務			2	2	
小計		19	20	18	20
選修	積體電路封裝導論	3	3		
	LINUX作業系統實習			1	2
	奈米科技概論			3	3
	積體電路設計概論			3	3
	網頁程式設計	3	3		
	輪形機器人基礎實務	3	3		
	網路概論	3	3		
	單晶片微電腦實務			3	3
	機器人組裝控制實務			3	3
	微處理機原理			3	3

第三學年(109)					
	科目	第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必修	◎分類通識	2	2	2	2
	※程式規劃元件實習	1	2		
	※實務專題(一)			1	1
小計		3	4	3	3
選修	積體電路模擬實務	3	3		
	雲端積體電路測試模擬實	3	3		
	半導體元件	3	3		
	積體電路工程	3	3		
	太陽能電池	3	3		
	數位積體電路佈局實務			3	3
	AI機器學習語言實務			3	3
	記憶體測試實務			3	3
	半導體製程技術			3	3
	積體電路封裝製程技術			3	3
	單晶片系統應用實務	3	3		
	行動通訊應用實務	3	3		
	單晶片能力認證	3	3		
	圖控程式設計	3	3		
	感測器應用實務			3	3
	Python實務			3	3
	觸控應用實務			3	3
	FPGA設計實務			3	3
	自動量測設計實務			3	3
	機器人應用實務			3	3
	電磁學	3	3		
	JAVA程式設計	3	3		
	硬體描述語言實務	3	3		
	必修	太陽能發電工程設計			3
通訊系統實務				3	3
手機APP程式設計				3	3

第四學年(110)						
	科目	第一學期		第二學期		
		學分	時數	學分	時數	
必修	※實務專題(二)	1	1			
	小計		1	1	0	0
選修	半導體製程實務	3	3			
	半導體元件製程模擬實務	3	3			
	射頻測試實務	3	3			
	先進積體電路封裝技術	3	3			
	記憶體佈局設計實務	3	3			
	積體電路封裝實務			3	3	
	AI積體電路測試分析實務			3	3	
	AI積體電路封裝檢測實務			3	3	
	混合積體電路佈局實務			3	3	
	半導體產業分析			3	3	
	積體電路可靠性工程			3	3	
	物聯網應用實務	3	3			
	無線電技術實務	3	3			
	手機與arduino控制			3	3	
	無線通訊產業概論			3	3	
	數位通訊實務	3	3			
	必修	工業安全與衛生	3	3		
		雲端技術實務			3	3
		工業安全與衛生實務			3	3

項目	學分	時數
◎通識課程	27	29
△專業基礎	14	16
※專業必修	34	39
專業選修	53	53
☆全民國防教育軍事訓練	0	2
合計	128	139

專業選修課程開課規劃	
學期	時數
第一學年第一學期	0
第一學年第二學期	0
第二學年第一學期	0
第二學年第二學期	6
第三學年第一學期	15
第三學年第二學期	15
第四學年第一學期	9
第四學年第二學期	9
開課時數總計	54

備註：

- 1.最低畢業學分：128學分；必修學分：75學分；選修學分：53學分
- 2.本系允許跨系選修，惟本系專業選修學分不得低於47學分
- 3.表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。

表中紅字經108.3.27教務會議通過